广州方邦电子股份有限公司

2024年度报告摘要

公司代码:688020　　公司简称:方邦股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者,在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下,公司2024年年度利润分配方案如下:公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8676元(含税)。截至2025年4月10日,公司总股本80,747,998股,以扣减回购专用证券账户中股份总数430,733股后的股本80,317,265股为基数,预计派发现金红利15,000,000元(含税),本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

本利润分配预案尚需2024年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王作凯	赵璇
联系地址	广州市黄埔区东枝路28号	广州市黄埔区东枝路28号
电话	020-82512686	020-82512686
传真	020-32203005	020-32203005
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案,现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻薄膜等。

其中电磁屏蔽膜、标准电子铜箔(以下简称"标箔")是公司报告期内的主要收入来源。

2、主要产品及服务情况

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别、具有复杂结构的薄膜,具有抑制电子元器件电磁干扰的功能,通过贴合于FPC产生作用。现代电子产品"轻薄短小"和高频高速化趋势更加明显,驱动着电子元器件及其组件内外部的电磁干扰、以及信号在传输中衰减问题逐渐严重,对电磁屏蔽膜的需求更大,同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为HSF6000和HSF-USB3两大系列。其中HSF-USB3系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜,具备自主研发的独特微针型结构,屏蔽效能进一步提高,同时可大幅降低信号传输损耗,降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

(2)铜箔产品

报告期内,公司铜箔产品主要包括带载体可剥离超薄铜箔(以下简称"可剥铜")、各类电子铜箔。

带载体可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板、HDI板的必需基材。目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10/10μm-40/40μm,用传统的减成法制程工艺无法制备,主要使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用可剥铜。公司生产的可剥铜具有厚度极薄、表面轮廓极低、载体层和可剥离层之间的剥离力稳定可控等特性,可满足mSAP的制程要求。

电子铜箔是制造覆铜板(CCL)、挠性覆铜板(FCCL)、印制电路板(PCB)、柔性电路板(FPC)的主要原材料,主要有高温高延伸铜箔(HTE箔,主要应用于多种类常规覆铜板及线路板)、反转处理铜箔(RTF箔,主要应用于高频高速板)和低轮廓铜箔(VLP箔,主要应用于高频高速、低损耗要求的电路板)等。公司生产的各类电子铜箔,厚度、延伸性、面密度、耐热性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

(3)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)是FPC的加工基材,由挠性绝缘层与金属箔构成。根据产品结构,挠性覆铜板可分为有胶三层挠性覆铜板(3L-FCCL)和无胶两层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据产品厚度,每类挠性覆铜板又分为普通型和极薄型。

下游电子产品快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密度互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连技术的关键材料之一,可大幅提升电子元器件组装密度并节约组装空间,并实现超细线路FPC的制备。公司采用自研自产原材料(主要是RTF铜箔和PI/TPI)的技术路径生产FCCL,可降低生产成本,同时实现其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标满足下游需求,具有良好的加工性能。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司采用"以产定购、批量订购"的采购模式,由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况,确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行ISO9000标准,采购价格确定方式主要采用询价模式。

2、生产模式

公司采用"以销定产、需求预测相结合"的生产模式,由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标,生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司电磁屏蔽膜核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等,铜箔生产核心环节为溶铜、生箔、后处理等,挠性覆铜板生产核心环节包括混胶合成、涂布、真空溅射、压合等。公司的产品为高端电子材料,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,上述生产环节均由公司自主完成,不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测,并对最终产品进行质量检验。

3、销售模式

报告期内,公司的销售模式为直销模式,直接客户为线路板厂商和覆铜板厂商,最终用户为智能手机、平板电脑以及汽车行业等品牌厂商。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况,自行针对目标市场进行产品开发,为下游客户提出解决方案;另一方面,公司和下游客户以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系,形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后,由下游客户进行打样、工艺验证和基本性能测试,通过后由封装/终端品牌厂商进行整体性能测试,之后通过小批量试产,验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致,公司即可量产、销售。

4、研发模式

公司长期坚持自主创新,采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面,通过与下游终端厂商的技术交流,了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜、超薄铜箔、挠性覆铜板等产品的个性化需求,进行定制式研发。在主动式研发方面,采用自主研发的设备,依靠自身积累的经验,根据市场需求,设计产品,生产部门配合研发实验室进行测试确认,不断优化实验方案,不断改进,最终确定方案进行小批量试产,试产成功后再进行大批量生产,逐步提升现有产品的性能。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"C3985电子专用材料制造"。

(2)行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如芯片封装、高性能高精密线路板制备密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成"卡脖子"困境。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。2018年颁布的《战略性新兴产业分类》,明确将"电磁波屏蔽膜"、"高频微波、高密度封装覆铜板"、"PCB用高纯铜箔"等电子专用材料列为重点产品。

报告期内,公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔,直接下游客户为线路板(PCB)厂商、覆铜板厂商,应用终端场景主要为消费电子,部分应用于汽车电子。

PCB有"电子产品之母"之称,能实现电子元器件的相互连接,起中继传输作用。近年来,随着5G通讯、消费电子、汽车电子等行业的快速发展,PCB市场规模逐年扩大,根据Prismark、高工产研(GGII)等机构的统计,2021年全球PCB产值已达804亿美元。然而,受全球经济下行、消费需求萎缩等因素影响,PCB市场需求在2022年四季度开始明显疲软,全球电子整机市场新增需求下降,PC、手机、电视等领域受到较大影响,预计2023年全球PCB产值将同比下滑15.0%,同时,需求疲软带来的价格压力也令产业链整体盈利能力水平下降。

然而,危机与机遇并存,以CHATGPT引发的新一轮人工智能及算力革命,AI PC/AI 手机及AI终端问世带来的新一轮消费电子的革新和重构,以及碳中和背景下新能源汽车产业及汽车电子化、智能化和网联化的快速发展,预计将在未来为PCB行业带来新一轮成长周期。根据Prismark预测,2022至2027年全球PCB产值复合增长率为3.8%,2027年全球产值将达到983.88亿美元;2022年至2027年中国PCB产值复合增长率为3.3%,2027年产值将达到511.33亿美元。

另一方面,回顾整个PCB发展历史,全球PCB产业初期由欧美国家厂商主导,随着日本PCB发展壮大,形成了欧美日共同主导的局面,进入21世纪后,亚洲地区由于具有劳动力成本优势,同时下游电子终端产业发展欣欣向荣,能够为PCB提供巨大的市场需求支持,因此吸引了全球PCB厂商的投资,欧美PCB产业大量外迁,全球PCB产业重心向亚洲转移,亚洲开始主导全球PCB产业,目前形成了以亚洲为中心(尤其是中国大陆)、其他地区为辅的新局面。

PCB产业在总体体量不断增长、重心不断往中国大陆集聚的同时,还呈现出技术不断升级的特点,表现为挠性板(FPC)、高密度互连板(HDI)、芯片封装基板等高性能电路板需求持续放量,同时埋入式无源元件的市场需求也在逐步显现。据Prismark统计及预测,全球FPC、HDI和封装基板2023-2028年的复合增长率分别为4.4%、6.2%和8.8%,至2028年三者产值分别为151.17亿美元、142.26亿美元和190.65亿美元。

全球PCB产值、技术路线整体呈上升趋势,增大了对公司电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔以及电阻薄膜等产品的市场需求。总体来看,电子专用材料市场增长前景可观,我国高端电子专用材料自给率仍较低,具有很大的成长空间。

(3)主要技术门槛

首先,公司长期深耕消费电子产业链,以电磁屏蔽膜产品为抓手,与华为、三星等世界顶尖企业建立了长期稳定的深度技术交流渠道和机制,可第一时间掌握5G通讯、芯片封装、超高清显示等关键行业最新的技术发展趋势及需求。

其次,公司拥有为上述技术发展趋势及需求快速提供相应产品及解决方案的独特能力。这种能力源自于公司拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术,并可实现各技术间的组合创新,这让公司在高端电子材料制造中拥有很强的优势。

原因在于,将导体材料与绝缘材料进行结合,形成高性能复合材料,这是制备高端电子材料的底层技术路径。一方面,通过自主开发的真空溅射、连续卷状电沉积技术,公司可生产各种功能的金属箔,如超薄铜箔、标准铜箔等,其厚度、粗糙度以及表面形貌可定制;另一方面,通过精密涂布以及特殊配方技术,公司可生产绝缘薄膜,例如PI、TPI以及BT树脂、改性环氧树脂、丙烯酸树脂等。具备以上基础后,通过将金属箔与绝缘膜进行搭配组合,公司可生产各种功能的高端电子材料(薄膜),如铜箔搭配PI/MPI,制备极薄挠性覆铜板以及特殊结构的复合金属箔、电阻薄膜等,从而快速地、定制化地满足下游终端的最新技术需求。电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程,涉及的原料配方、生产工艺、品质控制均较为复杂,同时下游应用持续对产品提出更高技术需求,企业必须不断改进生产工艺,不断升级、改善自主研发的关键设备和原料配方。随着技术的进步,产品升级速度不断提升,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应市场的发展。

目前公司主要产品关键技术难点及技术壁垒如下:

电磁屏蔽膜:屏蔽效能≥60dB,接地电阻≤200mΩ,同时满足极低插入损耗、轻薄、耐弯折、耐热耐化等严苛加工应用要求;

挠性覆铜板:铜层厚度2-9μm、12/18/35μm(可定制化),剥离强度≥10N/cm,尺寸稳定性(%)≤±0.08,同时满足耐热耐化等严苛加工应用要求;

带载体可剥离超薄铜箔:主要特点为厚度超薄、表面轮廓极低,铜层厚度1.5-6μm,铜层粗糙度0.5-2.0μm,剥离强度≥6N/cm,拉伸强度400N/mm2,延伸率≥5%;

标准铜箔:产品厚度12-35μm为主,可定制化,延伸性、面密度、表面粗糙度等符合客户要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司在行业内拥有较强技术水平,部分产品对标国外,满足供应链本土化

在电磁屏蔽膜领域,公司具有重要的市场、行业地位,市场占有率较高。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。

在挠性覆铜板领域,其主要原材料是铜箔、聚酰亚胺(PI)和热塑性聚酰亚胺(TPI),公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板,以逐步打破对国外上游供应链的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅降低生产成本,提升产品市场竞争力和经济效益。另一方面,制备极薄挠性覆铜板等高端产品,对铜箔厚度、粗糙度以及产品整体剥离力等要求很高,公司现有的技术、工艺和配方可满足以上技术需求。对于极薄挠性覆铜板,目前该产品全球量产供应商主要为日本的东丽和住友。公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板,其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进,具有优异的加工性能。

在超薄铜箔领域,公司生产的带载体可剥离超薄铜箔,目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔,其铜层厚度及表面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等关键指标达到世界先进水平。

(2)公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立了稳定的合作关系

凭借良好的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应,公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex等众多优质直接客户,并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切的技术交流与合作。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜将受益于5G-5.5G-6G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展。5G-5.5G-6G环境下,以智能手机、AR/VR硬件设备为代表的消费电子产品"轻薄短小"、高频高速化趋势愈加明显,其内部结构FPC使用量不断增加以提升内部组装密度,同时电子元器件之间的电磁干扰愈加严重,这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加,另一方面体现为电磁屏蔽膜性能提升的要求(如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗撕裂性更强等)。

折叠手机、AI手机也对电磁屏蔽膜提出了新的需求。折叠手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折。AI手机方面,据市场分析机构Canalys最新预测数据显示,2024年全球AI手机出货量占智能手机总出货量的16%,到2028年这一比例将激增至54%,年复合增长率(CAGR)为63%,AI手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题,要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能。

在国家"碳达峰、碳中和"目标提出之后,我国新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化趋势明显。随着汽车向电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现,FPC在车载领域的用量不断提升,应用涵盖显示模组、车灯、BMS/VCU/MCU控制系统、传感器、自动驾驶辅助系统等相关场景,市场预计单车FPC用量将超过100片。在上述FPC应用场景中,又因显示模组有其高清化需求,以及传感器系统需要接收5G信号、毫米波等高频高速信号以实现短延迟甚至零延迟的探测反馈和自动驾驶,这些高频高速电路存在对电磁屏蔽的潜在需求。

(2)挠性覆铜板

作为FPC的加工基材,挠性覆铜板将受益于FPC市场需求扩大及其细线化趋势。据市场分析机构Prismark数据及预测,近10年内,全球FPC产值规模不断扩张,复合增长率约3.3%,预计2028年全球FPC产值有望达到151.17亿美元;另一方面,各类电子产品"轻薄短小"、高频高速化趋势愈加明显,倒逼FPC线宽线距越来越精细,这加大了对高性能挠性覆铜板(如无胶二层FCCL、极薄FCCL)的需求,因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高,更能满足细线路FPC的加工制程。

另外特别值得注意的是新能源汽车对FPC的需求不断增大,对上游基材挠性覆铜板形成较强利好。一方面,动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。相较铜线线束,FPC由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点,在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势,此外FPC厚度薄,电池包结构定制,装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上,自动化程度高,适合规模化大批量生产,FPC替代铜线线束趋势明确,目前国内动力电池主流厂商已经在Pack环节批量化应用FPC。另一方面,FPC厂商进一步向下游CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)产品布局,通过FPC向CCS的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS产品由FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。

(3)铜箔产品

公司铜箔产品包括带载体可剥离超薄铜箔、标准电子铜箔等。

①带载体可剥离超薄铜箔是芯片封装基板(IC载板、类载板)、HDI板的基材,将受益于芯片制程先进化进程。

目前,半导体芯片技术快速发展、制程日益先进,客观上带动芯片封装领域的IC载板、类载板的细线化成为必然趋势,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由于其线宽线距极细,用传统的减成法制程工艺无法制备,主要使用mSAP。mSAP是制备芯片封装基板、类载板的主流技术路线,目前,鹏鼎控股、深南电路、安捷利-美维电子、三星电机等国内外大型电路板厂商均主要采用mSAP制备IC载板、类载板等。

一般铜箔无法满足mSAP制程要求,必须用到带载体可剥离超薄铜箔。用于mSAP工艺的铜箔,必须满足以下关键条件:A.厚度≤3μm,若无法达到该标准,mSAP将无法稳定"闪蚀"过厚的铜层,届时将依旧存在减成法特有的"侧蚀"现象,无法制作精细线路;B.表面轮廓Rz≤1.5μm,若无法达到该标准,过高的铜层表面粗糙度闪蚀不掉,无法制作精细线路,同时也会严重影响IC载板、类载板的高频高速特性;C.必须带有载体层和可剥离层,由于薄铜太薄,无法直接应用于实际加工,必须依赖载体层加以辅助稳定;同时,实际加工过程中,只有薄铜最终应用到精细线路制作,载体层必须撕掉,因此必须在薄铜与载体层之间设置可剥离层,同时,必须形成剥离力稳定可控的可剥离层,剥离力过高或过低,都将导致实际加工失败,因此剥离力是制备带载体可剥离超薄铜箔的重大技术难点。

当前,国内外高端芯片龙头企业对带载体可剥离超薄铜箔存在较大需求,以实现先进制程芯片与基板的精密互连。然而,带载体可剥离超薄铜箔全球市场被日本三井铜箔垄断,卡脖子问题严重,对与我国高端芯片封装领域密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业造成较大制约,实现带载体可剥离超薄铜箔的供应链本土化需求较为迫切。

②标准电子铜箔领域。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的主要原材料,随着5G通讯、计算机、汽车电子、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步,预计PCB产业仍将持续平稳增长,进而推动标准铜箔的发展。高工产业研究院(GGII)预测2020-2025年标准铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势,年复合增长率在7.4%左右,到2025年全球标准铜箔出货量将达73万吨,其中对高频、高速、低损耗的高性能铜箔的需求将越来越大,而高频高速铜箔目前我国大部分仍依赖进口,国产化空间广阔。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	1,800,120,282.08	1,945,328,988.11	-7.46	1,968,161,280.36	1,967,930,907.96
归属于上市公司股东的净资产	1,374,196,062.02	1,484,916,098.58	-7.46	1,544,148,205.84	1,544,140,869.74
营业收入	344,570,817.57	345,149,314.31	-0.17	312,626,261.30	312,626,261.30
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	306,986,897.88	329,331,001.93	-6.78	312,068,298.39	312,068,298.39
归属于上市公司股东的净利润	-91,642,742.25	-68,670,118.91	-33.45	-68,024,179.44	-68,018,043.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,768,813.12	-85,851,515.65	-31.35	-82,127,599.77	-82,121,464.29
经营活动产生的现金流量净额	-45,967,720.46	-12,803,081.70	-259.04	113,430,179.14	113,430,179.14
加权平均净资产收益率(%)	-6.43	-4.54	减少1.89个百分点	-4.31	-4.31
基本每股收益(元/股)	-1.14	-0.86	-32.56	-0.85	-0.85
稀释每股收益(元/股)	-1.13	-0.85	-32.94	-0.84	-0.84
研发投入占营业收入的比例(%)	17.97	16.10	增加1.87个百分点	19.46	19.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	67,434,073.96	81,059,640.80	93,068,105.65	103,008,997.16
归属于上市公司股东的净利润	-14,203,673.80	-7,751,550.96	-17,671,428.98	-52,016,088.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,328,290.92	-13,399,792.67	-22,241,211.14	-55,799,518.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,213,740.40	30,096,321.89	-16,910,673.60	-40,939,628.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,959
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	18.03	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有限公司	0	14,086,260	17.45	0	无	0	境内非国有法人
海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)	0	7,200,000	8.92	0	无	0	境内非国有法人
易红琼	0	4,979,672	6.17	0	无	0	境内自然人
李冬梅	20,379	2,368,089	2.93	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	未知	1,270,383	1.57	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀15号私募证券投资基金	0	950,000	1.18	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	未知	878,415	1.09	0	无	0	其他
章金楠	287,400	790,000	0.98	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀16号私募证券投资基金	0	631,800	0.78	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东;苏陟、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏陟与李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙),除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

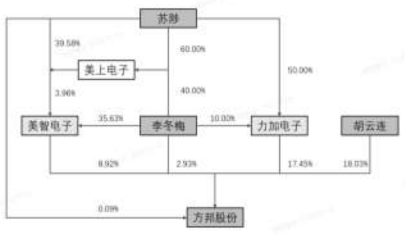
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

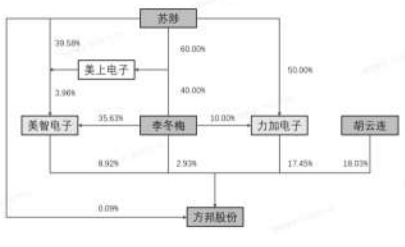
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入34,457.08万元,较上年基本持平,归属于母公司所有者的净利润-9,164.27万元,较上年同期下降33.45%,主要系:(1)屏蔽膜业务:2024全年屏蔽膜销量同比增加,但是由于产业链整体降成本、竞争加剧的影响,屏蔽膜销售单价略有下降,屏蔽膜整体盈利能力与去年同比基本持平;(2)铜箔业务:本报告期铜箔业务计提固定资产减值准备1566.78万元,同时在电子铜箔行业竞争进一步加剧的环境下,公司在提升产品良率、调整产品结构、主动控制产品出货量、降低生产成本等方面采取了一系列措施,并积极开发、销售RTF等毛利较高的铜箔产品,促使铜箔业务整体的亏损有所减少。(3)挠性覆铜板业务:本报告期挠性覆铜板销量大幅增长,作为行业新进者,为了开拓市场,销售单价较低,未达到规模经济,叠加固定资产折旧影响,挠性覆铜板业务尚处于亏损状态。(4)公司持续开展研发投入,报告期内新产品开发认证取得了一系列重要进展,如相关型号可剥铜已经通过部分载板厂商和主要芯片终端认证并获得了小批量测试订单,AI服务器高速铜缆屏蔽用铜箔产品关键技术指标获客户认可,柔性屏蔽罩已进入某主流品牌手机终端供应链等。然而,由于公司研发产品为基础复合电子材料,整体开发认证周期长,订单放量、稳定生产以及提升良率都需要时间,因此新产品显性贡献业绩尚需时间。(5)公司对报告期内可能发生信用减值损失的应收账款单项计提信用减值,影响本期归属于母公司所有者净利润1390.45万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2025-019

广州方邦电子股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利1.8676元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-91,642,742.25元,未分配利润为人民币152,840,535.39元,其中母公司累计可供股东分配利润为人民币335,446,468.32元。

经董事会决议,经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者,在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下,公司2024年年度利润分配方案如下:公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8676元(含税)。截至2025年4月10日,公司总股本80,747,998股,以扣减回购专用证券账户中股份总数430,733股后的股本80,317,265股为基数,预计派发现金红利15,000,000元(含税),本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,认为预案兼顾了股东回报和公司经营发展实际,同意将该预案提交本公司2024年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月16日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为:2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2025-020

广州方邦电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》等有关规定,广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份")董事会对2024年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币53.88元,共计募集资金107,760.00万元,扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后,公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-65号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司2019年度实际使用募集资金5,806.88万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,188.29万元;公司2020年度实际使用募集资金13,652.18万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,917.80万元;公司2021年度实际使用募集资金17,819.76万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,047.53万元;公司2022年度实际使用募集资金12,983.25 万元,2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394.66万元;公司2023年度实际使用募集资金4,351.72万元,2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,337.20万元;公司2024年度实际使用募集资金6,375.15万元,2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,200.10万元;累计已使用募集资金60,988.95万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,085.58万元。

截至2024年12月31日,募集资金余额为47,000.59万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有3个募集资金专户、3个结构性存款账户、9个大额存单账户、4个定存账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	9,136,607.90	活期存款
	12090789157900105	31,083,500.00	大额存单
	12090789157900122	10,873,694.44	大额存单
	12090789157900140	10,235,222.22	大额存单
	12090789157900153	155,000,000.00	定存
	12090789157800945	20,000,000.00	结构性存款
	12090789157800962	30,000,000.00	结构性存款
	12090789157900167	10,366,527.78	大额存单
	12090789157800980	50,000,000.00	结构性存款
华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000373094	6,067,448.49	活期存款
	10966000000556432	10,223,944.44	大额存单
	10966000000556421	20,447,888.89	大额存单
	10966000000566304	20,000,000.00	定存
	10966000000566291	20,000,000.00	定存
	10966000000566280	30,000,000.00	定存
	10966000000576163	10,566,611.11	大额存单
	10966000000578285	10,223,166.67	大额存单
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行	3602089129200232269	5,781,330.28	活期存款
	3602089114200005495	10,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行	44050147004209866666	-	账户已注销
合计		470,005,942.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,募集资金使用情况表详见本报告附件1。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项,使用自有资金支付募投项目人员费用,并定期以募集资金等额置换。华泰联合证券有限责任公司已于2021年9月17日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2024年12月31日,公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,2019年8月2日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品,其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2020年7月31日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币8.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2021年7月29日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2022年8月12日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2023年8月21日,公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2024年8月19日,公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

2024年度,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243,398.96万元,累计获取投资收益1,120.65万元,期末理财产品余额为44,902.06万元。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金投资项目使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议、2024年4月1日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"屏蔽膜生产基地建设项目"结项并将节余募集资金1,216.31万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)。

结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出,同时对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定收益。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司于2024年2月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之"挠性覆铜板生产基地建设项目"的后续产能建设,本项目募集资金预计剩余金额30,068.08万元,将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目,待审慎研究讨论确定后,将严格按照相关法律法规的规定,履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月17日

附件1:　　募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	97,903.96	本年度投入募集资金总额	6,375.15							
报告期内变更用途的募集资金总额(注1)	30,068.08	已累计投入募集资金总额	60,988.95							
累计变更用途的募集资金总额	30,068.08									
累计变更用途的募集资金总额比例	30.71%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
挠性覆铜板生产基地建设项目	是	55,194.63	31,075.72	4,283.48	29,173.78	93.88	项目第一期已于2022年12月达到可使用状态;第二期于2024年7月初达到可使用状态,已实现32.5万平方米/月的产能,公司将终止后续产能建设(详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009))。	-2,301.35	否	是
屏蔽膜生产基地建设项目	否	13,251.28	13,251.28	1,156.24	12,577.33	94.91	项目如期建成,设备如期完成安装调试,并于2022年12月完成环评验收,达到可使用状态,2023年2月达到量产状态,已结项。	-16.47	否	否
研发中心建设项目	否	20,206.00	20,206.00	935.44	9,922.76	49.11	项目于2022年12月达到可使用状态,目前进入研发项目的实施阶段。	不适用	本项目产出为科研成果,主要为公司产品提供技术支持。至本报告期末,各研发项目持续推进,较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代。	否
补充营运资金项目	否	9,252.05	9,252.05	-	9,315.09	100.68 (注3)	不适用	不适用	不适用	否
合计(注2)		97,903.96	73,785.05	6,375.15	60,988.95					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能。上述产能建设已完成,公司将终止后续产能建设(详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009))。本项目未达到计划进度或预计收益的原因:(1)近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响,挠性覆铜板产业链下游需求放缓;(2)公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板,以逐步打破对国外上游供应链的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅降低生产成本,提升产品市场竞争力和经济效益,但实施难度较大、周期长,报告期内订单持续上量,但未能充分摊薄项目设备折旧等形成的固定成本;(3)在项目实施过程中,受下游环境变化、公司采取自研自产原材料的战略定位导致的研发、认证周期长等因素影响,公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发,决定全力消化已有产能,终止后续产能建设。 2、屏蔽膜项目未达到预计收益的原因:(1)由于产业链整体成本上升和市场竞争加剧,引起更高价格的usb3系列出货量变少,故屏蔽膜的销售单价略有下降,导致盈利能力有所降低,未能达到募投项目可行性论证时的预期水平;(2)公司在可剥铜、挠性覆铜板、屏蔽膜、薄膜电阻、热敏电阻等领域集中研发,受研发规划影响公司研发费用率偏高,影响了短期盈利;(3)公司在广州建设了新的生产和研发基地,导致折旧、能耗(公辅工程)等固定费用偏高,影响了盈利能力。 3、研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益; 4、补充运营资金项目用于补充流动资金,项目效益反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、挠性覆铜板项目:鉴于下游产业链需求放缓、公司采取自研自产原材料的战略定位导致本项目研发、认证周期长等因素影响,公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发,决定全力消化已有产能,终止本项目后续产能建设。本事项已经2024年2月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及2024年3月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过,详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009)《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-013)。 2、屏蔽膜项目已于2023年2月结项,不存在项目可行性重大变化的情况;研发中心项目及补充运营资金项目无重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2024年12月31日,公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、屏蔽膜项目已结项,该项目募集资金结余为1,216.31万元,主要原因系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出,同时对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定收益。详情见披露于上海证券交易所的《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-004)。 2、挠性覆铜板项目已终止,该项目募集资金结余预计为30,068.08万元,项目终止后结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009)《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-013)。									
尚未使用募集资金用途及去向	2024年度,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243,398.96万元,累计获取投资收益1,120.65万元,期末理财产品余额为44,902.06万元。其余募集资金均存放于募集资金专户,尚未使用的募集资金将继续按照募集资金相关法规严格管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:详见上文"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。

注2:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

注3:上表中"补充营运资金项目"募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2025-022

广州方邦电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过1000万美元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意根据公司实际经营需要,充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险,使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、开展套期保值业务的必要性

公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金的使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1、业务品种

公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、日元等。

2、业务规模及期限

公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过1000万美元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

3、授权事项

公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,可能会造成汇率的大幅波动,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务,优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和套期保值业务,并报董事长批准。未经董事长授权或审批,其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格执行资金划拨和使用的审批程序,最大程度降低信用风险。

3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司管理层决策。

5、公司制定了相关制度,对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将有效执行制度,严格控制业务风险。

五、已履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上,监事会一致同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2025-023

广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》,同意根据公司的经营发展需要,公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要,拟与银行等金融机构开展即期余额不超过2亿元的票据池业务,最终额度以银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内,公司董事会授权董事长(或其指定的授权代理人)办理上述事宜,并代表公司与银行签署上述业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下:

一、票据池业务基本情况

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行,具体合作银行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素决定。

3、实施主体

票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司,不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。

4、实施额度

拟开展票据池业务的额度不超过2亿元人民币,即公司及合并范围内子公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过2亿元人民币,在上述额度范围内,可循环使用。

5、业务期限

授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月。

6、担保方式

在风险可控的前提下,公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,具体每笔担保形式及金额授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

1、降低管理成本

通过开展票据池业务,公司及合并报表范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理,由合作金融机构代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构,减少管理风险,降低管理成本。

2、平衡公司及合并报表范围内子公司的持票量与用票量

通过开展票据池业务,能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,按需进行额度调剂,有利于解决公司与合并报表范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题,全面盘活票据资产。

3、提高资金使用效率

公司及合并报表范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据,用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高资金利用率。

三、风险分析与控制措施

1、流动性风险

开展票据池业务,需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司及合并报表范围内的子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押,向合作金融机构申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作金融机构要求公司追加担保。

风险控制措施:公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务后,将建立票据池台账,安排专人与合作银行对接,进行跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况以及安排新收票据入池,保证票据池的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、董事会授权董事长在授权额度及业务期限内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、公司财务部及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司管理层报告。

3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2025-024

广州方邦电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘大信为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任该所的上市公司)同行业上市公司审计客户134家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

(下转B126版)